

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 22 日 (22.09.2005)

PCT

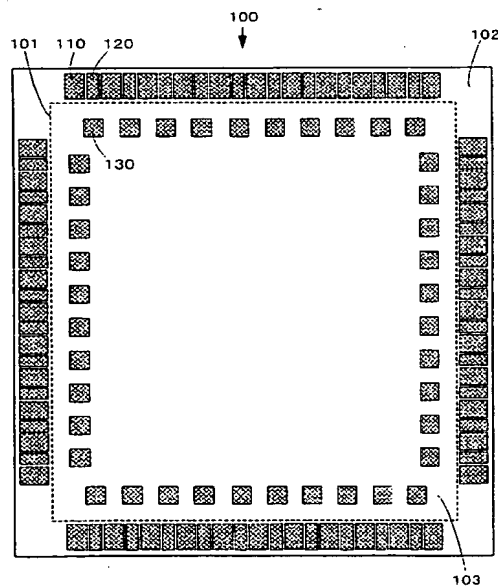
(10) 国際公開番号
WO 2005/088702 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/822, G01R 31/28, (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
H01L 21/3205, 21/60, 21/82, 27/04 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004571
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 15 日 (15.03.2005)
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小松 茂行 (KO-
MATSU, Shigeyuki).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (74) 代理人: 中島 司朗, 外 (NAKAJIMA, Shiro et al.); 〒
5310072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目 2 番 1 号淀川
5 番館 6 F Osaka (JP).
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-074283 2004 年 3 月 16 日 (16.03.2004) JP
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置



(57) Abstract: A semiconductor device with a reduced area is provided without damaging a functional element under a pad by stress. The semiconductor device is provided with a plurality of the pads, which are terminals for external connection, on a semiconductor substrate. On a main plane of the semiconductor device, a dual purpose pad to be used for both probe inspection and assembly is provided in a first area where a probe needle is permitted to apply pressure during probe inspection. On the main plane of the semiconductor device, an assembly pad not to be used for the probe inspection is provided in a second area where the probe needle is not permitted to apply pressure during the probe inspection.

(57) 要約: パッド下の機能素子が応力によるダメージを受けることなく、面積を縮小することができる半導体装置を提供することを目的とする。半導体基板上に外部接続用の端子である複数のパッドを有する半導体装置であって、当該半導体装置の主面における、プローブ針によるプローブ検査時の加圧が許可された第1の領域に、プローブ検査及び組立の両方に用いる

[続葉有]



WO 2005/088702 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。